

販売、各種ケーブルのOEM販売

USB TypeC ケーブル

各種ケーブルのOEM販売

商事株式会社

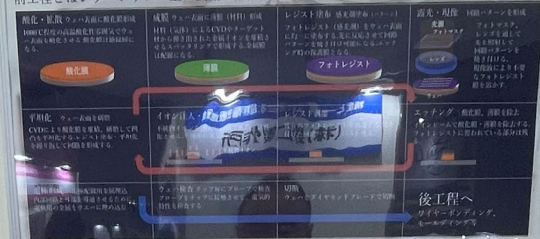
焼入れ・焼戻し 固溶化熱処理 焼鈍 真鍮ろう付け 時効処理 析出硬化処理

HIP処理

内部欠陥除去 焼結 拡散接合

半導体製造プロセスを支える、熱処理技術

半導体製造【前工程】に使用される装置部品に当社の技術が利用されています。前工程とはシリコンウェハ上に回路を形成するプロセスのことで、概要は以下の通りです。



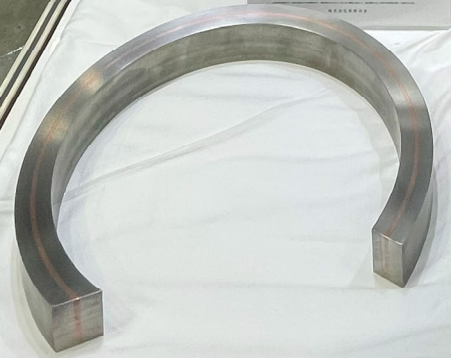
成膜、レジスト、露光・現像、エッチング、平坦化等で使用される材料、装置部品に当社の内部欠陥除去・焼結・拡散接合・真空ろう付け等の熱処理技術が使用されています!!! (ターゲット材料、レンズ、パッキングプレート、サセプター、ヒーター、チャンバー他)

当社が選ばれる理由

- ・ISO9001、JISQ9100に基づく品質管理及び特殊工程管理体制
- ・国内で希少な技術であるHIP処理
- ・不良率0%、納期遵守率99.7%達成によるお客様からの信頼

株式会社東都冶金 Tohto Yakin Co., Ltd. 所在地 〒222-0001 神奈川県横浜市港北区神3丁目7番105号
TEL 045-546-2121 HIP <https://www.totyakin.co.jp/>

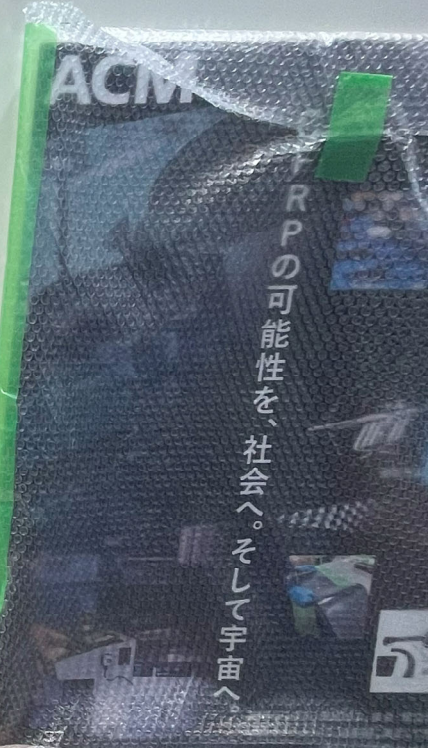
This area contains several informational cards and tools. One card shows a cross-section of a metal part with internal defects being removed. Another card shows a process flow diagram. Tools include a large metal ring and various smaller components.



貴名受

株式会社東都冶金

代表取締役 徳田 裕介



TRPの可能性を、社会へ。そして宇宙へ。